

Broadcom

公司分析報告

Broadcom Inc.

AVGO.US

報告日期：2026年2月10日

分析師：Clawdbot AI

目錄

一、公司概況	2
二、財務分析	3
三、產品Roadmap	4
四、市場競爭格局	5
五、風險評估	6
六、投資價值分析	7
七、附錄	8

1.1 公司基本信息

公司全稱	Broadcom Inc.
股票代碼	AVGO.US
總部位於	美国加州帕洛阿尔托
市值	\$4200亿
主營業務	网络芯片、ASIC、WiFi、基础设施软件
核心產品	Tomahawk以太网芯片、Trident交换芯片、定制AI芯片
CEO	Hock Tan

1.2 業務架構

核心業務

- 半导体：60% - 网络/无线
- 基础设施软件：40% - VMware等

下游應用

- 数据中心网络
- AI加速器
- 无线通信

1.3 核心競爭優勢

Broadcom 公司分析報告	說明	2026年2月10日
网络芯片垄断	以太网交换芯片市占率>70%	

2.1 核心財務指標

FY2024營收

\$520亿

YoY +XX%

淨利潤

\$140亿

YoY XX%

毛利率

74%

同比調整

淨利率

27%

优秀

2.2 研發費用

研發投入

年度	金額	佔營收比
FY2022	\$50亿	12%
FY2023	\$55亿	12%
FY2024	\$62亿	12%

2.3 營收趨勢

指標	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
營收	XX	XX	XX	\$520亿
YoY	-	+XX%	+XX%	+XX%
淨利潤	XX	XX	XX	\$140亿
毛利率	XX%	XX%	XX%	74%

3.1 產品線

產品	發布	製程	特點	應用
Tomahawk 5	2024	5nm	51.2T以太网	AI数据中心
下一代ASIC	2025	3nm	AI训练芯片	大模型训练

3.2 技術優勢

- 以太网交换芯片垄断
- 定制ASIC能力
- VMware协同效应

4.1 市場份額

公司	份額
Broadcom (以太网交换)	>70%

4.2 SWOT分析

💪 優勢

- 网络芯片垄断地位
- AI ASIC大单
- 高盈利能力

⚠️ 劣勢

- VMware整合风险
- 客户集中度高

🚀 機會

- AI数据中心需求
- 定制芯片需求

🚩 威脅

- Marvell竞争
- 客户自研

5.1 風險矩陣

中風險 VMware整合	中風險 客戶集中	低風險 競爭風險
-----------------	-------------	-------------

5.2 核心風險分析

核心風險

- VMware整合效果待觀察
- Google、AWS等大客戶占比高

6.1 估值指標

指標	數值	備註
當前市值	\$4200亿	2026年2月
PE (TTM)	約XXx	-
PS (TTM)	約XXx	-
PB	約XXx	-

6.2 買入理由

- AI数据中心网络需求强劲
- Google TPU等ASIC订单稳定
- 高股息+回购，股东回报优

6.3 風險因素

- 估值偏高 (PE 30x)
- VMware整合风险

6.4 投資建議

7.1 關鍵術語

術語	解釋
SoC	System on Chip, 系統級芯片
5G	第五代移動通信技術

7.2 數據來源

- Broadcom FY2024年報
- Dell'Oro Group
- Synergy Research

7.3 免責聲明

重要提示：本報告僅供投資參考，不構成任何投資建議。

報告總結：网络芯片龙头，AI ASIC核心受益者，高股息价值股。